



# 半導体用ウェットエッチング剤 界面活性剤入りリバッファードフッ酸 BHF-U シリーズ

ウェットエッチング剤 界面活性剤入りリバッファードフッ酸 BHF-U シリーズは、フッ化水素酸とフッ化アンモニウムの混合品に独自の界面活性剤を添加したタイプです。半導体製造向けに金属イオンなどの不純物を大幅に低減した高品質に加え、浸透性の向上やウェハーへの粒子付着を低減したエッチング剤です。

## 1. 一般物性

項目	単位	数値
HF 濃度	mass %	混合比率による
NH <sub>4</sub> F 濃度	mass %	

### 【検査項目】

塩化物、硝酸塩、リン酸塩、アニオン系物質、カチオン系物質、微粒子

\* 個別の品質につきましては、お問合せ下さい。

## 2. 取扱方法／安全情報

使用前に必ず SDS をお読み下さい。

該当法規に従い、包装、表示、輸送を行なって下さい。

## 3. 梱包仕様

5kg、20kg、100kg、1000kg

### 【連絡先】ダイキン工業株式会社 化学事業部

本社) 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目 4-12 梅田センタービル

東京) 〒108-0075 東京都港区港南二丁目 18-1 JR品川イーストビル

<http://www.daikin.co.jp/chm/>